

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 8 月 4 日 (2005.8.4)

【公開番号】特開 2003-209058 (P2003-209058A)
【公開日】平成 15 年 7 月 25 日 (2003.7.25)
【出願番号】特願 2002-6297 (P2002-6297)
【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/205

C 2 3 C 16/44

【F I】

H 0 1 L 21/205

C 2 3 C 16/44 J

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 1 月 12 日 (2005.1.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の成膜室を有する半導体製造装置において、
各成膜室の排気ラインは共通ラインに至り、この共通ラインに除害装置が接続され、
いずれかの成膜室でクリーニング時期に達すると、クリーニング時期に達した成膜室と他の成膜室を併せてクリーニング処理することを特徴とする半導体製造装置。